

ハイブリッドIC用 セラミック厚膜基板の製造

光山電気工業株式会社
秋田工場

厚膜基板は絶縁基板上に貴金属系ペースト等を用い、高度の設計技術と膜形成技術により高密度のパターン形成が実現できます。
又、両面、スルーホール、ファンクショントリミングによる高機能化が可能です。

弊社の厚膜基板ラインの特徴

- 1、お客様のご要求に合わせた小回りの効いた対応。
- 2、ISO14001を取得し、継続的な環境活動。
- 3、Ag - Pd、Ag - Pt、Au、Ag等の各材料に対応。
- 4、技術的特徴
スルーホール印刷
端面、楕円スルーホール印刷
ファインパターン印刷

厚膜印刷製造フロー

パターン設計



お客様より受領した回路図や構想案を基にパターン設計を行います。

印刷



スクリーン印刷にてセラミック基板に回路パターンを印刷により形成します。

乾燥・焼成



印刷された基板は乾燥されその後850℃の高温で焼成します。

外観検査



お客様の仕様に基づき外観検査を行います。

トリミング



抵抗体を所定の抵抗値にYAGレーザーでカットします。

主要生産設備

- ・ スクリーン印刷機
- ・ 膜厚計
- ・ 乾燥炉
- ・ 恒温槽
- ・ 焼成炉
- ・ N2焼成炉
- ・ レーザートリマー